

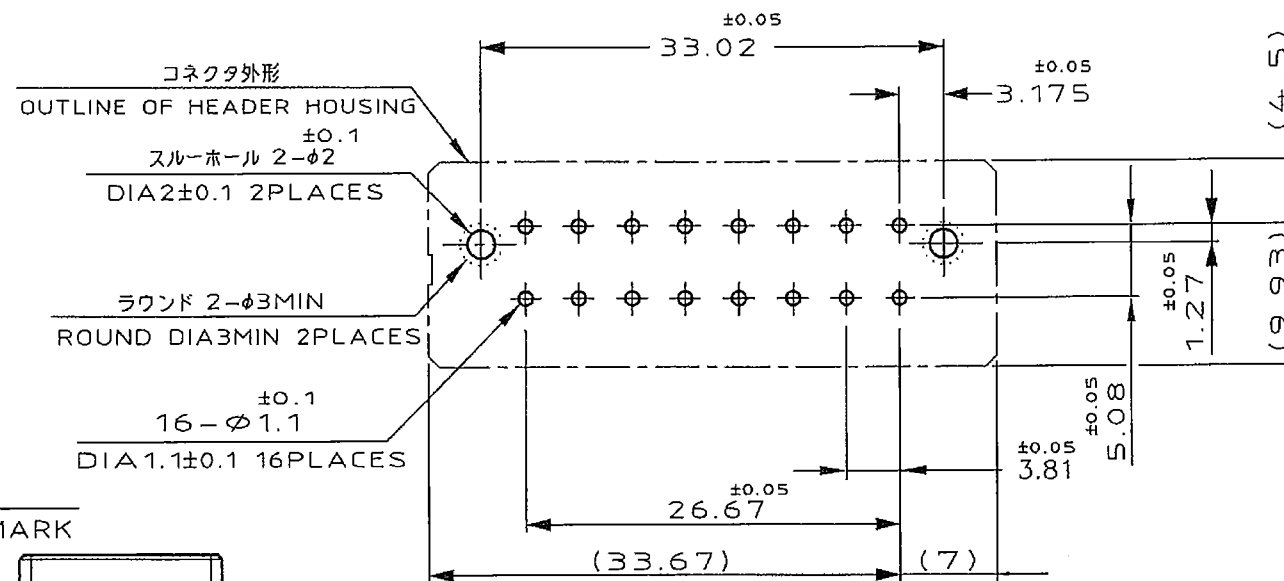
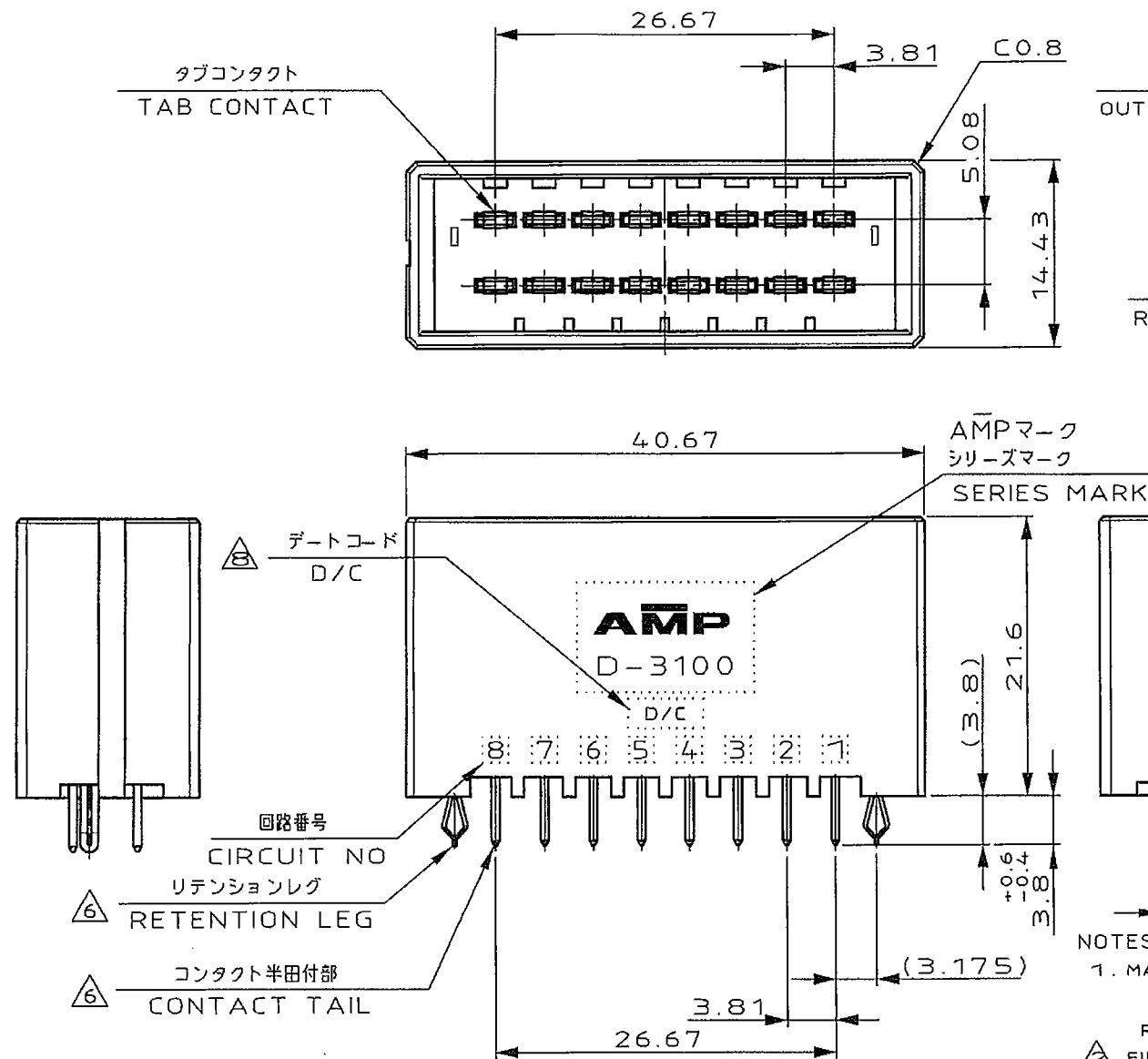
NUMBER 178327



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
- THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMNS OR FIVE COLUMNS. (INCLUDE THE ALPHABET)

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき
- 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません
- 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。

△	△	178327-6
△	△	178327-5
△	△	178327-3
△	△	178327-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

E3 REVISED

N.W.K.Z.X.X

LTR REVISION RECORD DR CHK DATE

DR. 19 APR 94 DE. 19 APR 94

CHK. N. Matsubara APP. N. Matsubara

20 APR 94 20 APR 94

S. MANABE S. MANABE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
mm²(AWG -)		mm²	16 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
			A3 J	C-178327
			SCALE	REV. SHEET
			2-1	E3 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面